

印刷電路板預熱機

C SUN 志聖

CSL-APH



CSL-APH 印刷電路板預熱機

基板尺寸 Panel Dimension	長度：250~640 mm (10"~25") 寬度：250~640 mm (10"~25") 板厚：0.05(不含銅)~3.2mm	Length : 250~640mm(10" ~ 25") Width : 250~640mm (10" ~ 25") Thickness : 0.05(without copper) ~ 3.2 mm
壓膜製程 Lamination Process	輸送速度：1~4M/min(可調) 熱壓輪兩組 4 支：φ78.6 mm x 760 mm 電力 1.5KW/支(選配可加增一組) 熱壓輪溫度：室溫~120°C(感應式加熱) 熱壓輪壓力：AIR 氣壓 2~4kg/cm ² 製程能力：4 pcs/min	Conveyor Speed : 1~4M/min (adjustable) 2 set heat roller : φ78.6 mm x 760 mm Power:1.5KW/pic(Option:3pairs) Temperature : Ambient to 120°C Pressure: AIR 2~4kg/cm ² Processing capacity : 4 pcs/min
溫度控制 Temperature Controller	電力：AC200V 3φ 50HZ 氣壓：5 kgf/cm ² 以上	Power:AC200V 3φ 50HZ Compressed Air : 5kgf/cm ²
公共需求 Utilities	PID 方式 + S.S.R. 驅動	PID control + S.S.R.driving
控制方式 Operation Control	可程式控制器	PLC
機台尺寸 External Dimension	長 393 x 寬 1273 x 高 1638mm 入料高度：950+50mm	W 393 x D1273 x H1638mm Pass line : 950+50mm

受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知。
Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.

DM20110302

志聖總公司(台北廠)

244 新北市林口區
工二工業區工八路 2-1 號
TEL:886-2-2601-7706
FAX:886-2-2602-4260

竹科分公司

300 新竹市科學園區
工業東九路 7-2 號 3F
TEL:886-3-666-2883
FAX:886-3-666-2892

台中廠

407 台中市西屯區
工業十路 17 號
TEL:886-4-2359-1651
FAX:886-4-2350-1860

志聖科技(廣州)

510850 廣州市花都區
獅嶺鎮利和路 6 號
TEL:86-20-8684-6341-3
FAX:86-20-8691-0139

東莞分公司

TEL:86-769-8533-1146
FAX:86-769-8533-1145

昆山分公司

TEL:86-512-5778-0230
FAX:86-512-5778-0229